DEDI AVAILABLE CUPT

OPTICAL WAVEGUIDE DEVICE AND OPTICAL TRANSMISSION AND RECEPTION DEVICE, AND MANUFACTURE THEREOF

Patent number:

JP2000227524

Publication date:

2000-08-15

Inventor:

OGAWA TAKESHI

Applicant:

SONY CORP

Classification:

- international:

G02B6/42; G02B6/36; G02B6/42; G02B6/36; (IPC1-7):

G02B6/122; G02B6/13; H01L31/12

- european:

G02B6/42C6

Application number: JP19990029258 19990205 Priority number(s): JP19990029258 19990205

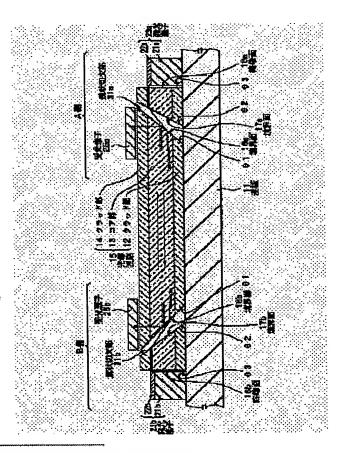
Report a data error h

Also published as:

US6477296 (E

Abstract of JP2000227524

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the optical waveguide device and optical transmission and reception device which enables two-way communication by propagating light signals bidirectionally by using an optical waveguide formed on a substrate and their manufacture. SOLUTION: In an optical waveguide 15 at least nearby its one end side (side A), a grooved cut part 31a having border surfaces 16a and 17a is provided crossing a light propagation direction. Received signal which is propagated in the optical waveguide 15 from the other end side (side B) is reflected internally by the border surface 16a and exits from the flank of the optical waveguide 15. Transmitted light which is made incident on the end surface 18a on the side A of the optical waveguide 15 is transmitted through the border surface 17a and made incident on the border surface 16a. Even the optical waveguide formed on the substrate is able to send and receive light signals in two directions and the density of optical wiring can be made high.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-227524 (P2000-227524A)

(43)公開日 平成12年8月15日(2000.8.15)

(51) Int.Cl.'		識別記号	FΙ		7	-7]-ド(参考)	
G 0 2 B	6/122		G 0 2 B	6/12	В	2H047	
	6/13		H01L	31/12	В	5F089	
H01L	31/12		G02B	6/12	M		

審査請求 未請求 請求項の数33 OL (全 11 頁)

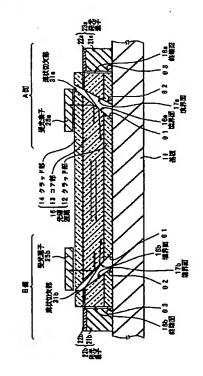
		母互明水 木明水 明水头V数30 UL (主 II 兵)
(21)出願番号	特顏平11-29258	(71)出願人 000002185 ソニー株式会社
(22)出顧日	平成11年2月5日(1999.2.5)	東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(72)発明者 小川 阿 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニ 一株式会社内 (74)代理人 100098785 弁理士 藤島 洋一郎 Fターム(参考) 2H047 KAD4 KA15 MA07 PA02 PA21 PA24 PA28 QA05 RA00 TA00 TA44 5F089 AA01 AC10 AC16 CA03

(54) 【発明の名称】 光導波装置および光送受信装置、ならびにそれらの製造方法

(57)【要約】

【課題】 基板上に形成された光導波路を用いて光信号 を双方向に伝搬させることにより双方向通信を可能にし た光導波装置および光送受信装置、ならびにそれらの製 造方法を提供する。

光導波路15の少なくとも一終端側 【解决手段】 (A側) の近傍における光導波路中に、光伝搬方向と交 差するようにして、境界面16a,17aを有する溝状 切欠部31aを設ける。他端側(B側)から光導波路1 5中を伝搬してきた受信光は、境界面16aで内面反射 し、光導波路15の側面から外部に出射する。光導波路 15のA側の終端面18aから入射した送信光は、境界 面17aを透過して境界面16aに入射する。基板上に 形成された光導波路においても、比較的単純な構成によ り双方向の光信号の送受信が可能となり、光配線の高密 度化が違成できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に形成されると共に、光を双方向に伝搬可能な光導波路と、

前記光導波路の少なくとも一終端の近傍における光導波 路内に光伝搬方向と交差するように設けられ、前記光導 波路内を伝搬する光を転轍することが可能な溝状切欠部 とを備えたことを特徴とするとを特徴とする光導波装 置。

【請求項2】 前記光導波路は、

光が伝搬するコア部と、

このコア部を囲むように形成されたクラッド部とを含んで構成されていることを特徴とする請求項1 記載の光導波装置。

【請求項3】 前記溝状切欠部は、少なくとも前記コア部を横断するように形成されていることを特徴とする 請求項2記載の光導波装置。

【請求項4】 前記溝状切欠部は、

前記光導波路内を伝搬してきた受信光を内面で反射させて、光導波路内から外部に導くことが可能な第1の境界面と、

前記受信光の伝搬方向と相反する方向に向かう送信光を 通過させて、光導波路内に導くことが可能な第2の境界 面とを有することを特徴とする請求項1 記載の光導波装 質。

【請求項5】 前記光導波路の要部を構成する材料の 屈折率がnである場合において、

前記第1の境界面の前記光伝搬方向に対してなす角度 θ 1 (度)、および、前記第2の境界面の前記光伝搬方向に対してなす角度 θ 2 (度)が、それぞれ、以下の式を満たすことを特徴とする簡求項 4 記載の光導波装置。

 $\theta \, 1 < 90 - sin^{-1} \, (1/n)$

 $\theta 2 > 90 - \sin^{-1}(1/n)$

【請求項6】 前記光導波路の少なくとも一終端が、 前記光伝搬方向とほぼ直交すると共に、外部から入射し た送信光をほぼそのままの方向に通過させることが可能 な端面をなし、

前記端面を通過して入射してきた送信光が、前記第2の 境界面、溝状切欠部の内部および第1の境界面を順に通 過して、前記光導波路内に導かれるようにしたことを特 徴とする請求項4記載の光導波装置。

【請求項7】 前記光導波路の少なくとも一終端が、前記光伝搬方向に対してこれと交差するような所定の角度をなすと共に、光導波路の上面または側面から入射した送信光を内面で反射させることが可能な端面をなし、前記端面で反射した送信光が、前記第2の境界面、前記溝状切欠部および第1の境界面を順に通過して、前記光導波路内に導かれるようにしたことを特徴とする請求項4記載の光導波装置。

【請求項8】 光導波路の要部を構成する材料の屈折率がnである場合において、

前記端面の前記光伝搬方向に対してなす角度 θ 3 (度) が、以下の式を満たすことを特徴とする請求項 7 記載の 光導波装置。

 $\theta 3 < \sin^{-1}(1/n)$

【簡求項9】 前記光導波路は、高分子材料を用いて構成されたものであることを特徴とする簡求項1記載の光導波装置。

【請求項10】 前記基板は、シリコン、石英、ガラス およびセラミックスの少なくとも1つを含む無機材料、 または有機材料を用いて構成されたものであることを特 徴とする請求項1記載の光導波装置。

【請求項11】 基板上に形成されると共に、光を双方向に伝搬可能な光導波路と、

前記光導波路の少なくとも一終端の近傍における光導波路内に光伝搬方向と交差するように設けられ、前記光導波路内を伝搬する光を転轍することが可能な溝状切欠部 と

前記溝状切欠部により転轍された受信光を受光する受光 素子と、

20 前記溝状切欠部に向けて送信光を発する発光素子とを備えたことを特徴とする光送受信装置。

【請求項12】 前記光導波路は、

光が伝搬するコア部と、

このコア部を囲むように形成されたクラッド部とを含んで構成されていることを特徴とする請求項11記載の光送受信装置。

【請求項13】 前記溝状切欠部は、少なくとも前記 コア部を横断するように形成されていることを特徴とす る請求項12記載の光送受信装置。

30 【請求項14】 前記溝状切欠部は、

前記光導波路内を伝搬してきた受信光を内面で反射させて、光導波路内から外部に導くことが可能な第1の境界面と、

前記受信光の伝搬方向と相反する方向に向かう送信光を 通過させて、前記光導波路内に導くことが可能な第2の 境界面とを有することを特徴とする請求項11記載の光 送受信装置。

【請求項15】 光導波路の要部を構成する材料の屈 折率がnである場合において、

40 前記第1の境界面の前記光伝搬方向に対してなす角度 θ 1 (度)、および、前記第2の境界面の前記光伝搬方向 に対してなす角度 θ 2 (度)が、それぞれ、以下の式を 満たすことを特徴とする請求項14記載の光送受信装 置。

 $\theta = 1 < 90 - \sin^{-1} (1/n)$ $\theta = 2 > 90 - \sin^{-1} (1/n)$

【請求項16】 前記受光素子は、前記第1の境界面の近傍における光導波路の上面または側面に配置され、第1の境界面で反射された受信光を受光可能であること を特徴とする請求項14記載の光送受信装置。

前配光導波路の少なくとも一終端 【請求項17】 が、

前記光伝搬方向とほぼ直交すると共に、外部から入射し た送信光をほぼそのままの方向に通過させることが可能 な端面をなし、

前記端面を通過して入射してきた送信光が、前記第2の 境界面、溝状切欠部の内部および第1の境界面を順に通 過して、前記光導波路内に導かれるようにしたことを特 徴とする請求項14記載の光送受信装置。

前記発光素子は、前記端面に対向し 10 て配置され、端面に向けて送信光を発することを特徴と する請求項17記載の光送受信装置。

前記発光素子は、端面より光が出射 【請求項19】 する発光層を有するものであることを特徴とする請求項 18記載の光送受信装置。

【請求項20】 前記光導波路の少なくとも一終端 が、

前記光伝搬方向に対してこれと交差するような所定の角 度をなすと共に、光導波路の上面または側面から入射し た送信光を内面で反射させることが可能な端面をなし、 前記端面で反射した送信光が、前記第2の境界面、前記 **溝状切欠部および第1の境界面を順に通過して、前記光** 導波路内に導かれるようにしたことを特徴とする請求項 1 4 記載の光送受信装置。

前記発光素子は、前記光導波路の上 【鯖求項21】 面または側面に配置されていることを特徴とする請求項 20記載の光送受信装置。

前記発光素子は、表面より光が出射 【請求項22】 する発光層を有するものであることを特徴とする請求項 20記載の光送受信装置。

【請求項23】 光導波路の要部を構成する材料の屈折 率がnである場合において、

前記端面の前記光伝搬方向に対してなす角度 θ 3 (度) が、以下の式を満たすことを特徴とする請求項20記載 の光送受信装置。

 $\theta \, 3 < s \, i \, n^{-1} \, (1/n)$

【請求項24】 基板上に、光を双方向に伝搬可能な 光導波路を形成する工程と、

前記光導波路の少なくとも一終端の近傍における光導波 路内に、この光導波路内を伝搬してきた受信光を内面で 40 反射させて光導波路の上面または側面から外部に出射さ せることが可能な第1の境界面および前記受信光の伝搬 方向と相反する方向に向かう送信光を通過させて前記第 1の境界面を介して光導波路内に導くことが可能な第2 の境界面を有する溝状切欠部を、光伝搬方向と交差する ように形成する工程と、

を含むことを特徴とする光導波装置の製造方法。

光導波路の要部を構成する材料の屈 【簡求項25】 折率がnである場合において、

前記第1の境界面の前記光伝搬方向に対してなす角度 heta 50 heta 2 > 9 0 - s i n^{-1} (1 \diagup n)

1 (度)、および、前配第2の境界面の前配光伝搬方向 に対してなす角度 θ 2 (度) が、それぞれ、以下の式を 満たすようにしたことを特徴とする請求項24記載の光 導波装置の製造方法。

 $\theta \, 1 < 90 - s \, i \, n^{-1} \, (1 / n)$

 $\theta 2 > 90 - \sin^{-1}(1/n)$

【請求項26】 前記光導波路の少なくとも一終端

前記光伝搬方向とほぼ直交すると共に、外部から入射し た送信光を通過させて前記第2の境界面の方向に導くこ とが可能な端面をなすようにしたことを特徴とする請求 項24記載の光導波装置の製造方法。

前記光導波路の少なくとも一終端 【請求項27】 が、

前記光伝搬方向に対してこれと交差するような所定の角 度をなすと共に、光導波路の上面または側面から入射し た送信光を内面で反射させて前記第2の境界面の方向に 導くことが可能な端面をなすようにしたことを特徴とす る請求項24記載の光導波装置の製造方法。

【請求項28】 光導波路の要部を構成する材料の屈折 率がnである場合において、

前記端面の前記光伝搬方向に対してなす角度 83 (度) が、以下の式を満たすようにしたことを特徴とする請求 項27記載の光導波装置の製造方法。

 $\theta \, 3 < s \, i \, n^{-1} \, (1 / n)$

30

基板上に、光を双方向に伝搬可能な 【請求項29】 光導波路を形成する工程と、

前記光導波路の少なくとも一終端の近傍における光導波 路内に、この光導波路内を伝搬してきた受信光を内面で 反射させて光導波路の上面または側面から外部に導くこ とが可能な第1の境界面および前記受信光の伝搬方向と 相反する方向に向かう送信光を通過させて前記第1の境 界面を介して光導波路に導くことが可能な第2の境界面 を有する溝状切欠部を、光伝搬方向と交差するように形 成する工程と、

前記第1の境界面の近傍における光導波路の側面に、第 1の境界面で反射された受信光を受光するための受光素 子を形成する工程と、

前配端面の近傍に、この端面に向けて送信光を発するた めの発光素子を形成する工程と、

を含むことを特徴とする光送受信装置の製造方法。

光導波路の要部を構成する材料の屈 【簡求項30】 折率がnである場合において、

前記第1の境界面の前記光伝搬方向に対してなす角度θ 1 (度)、および、前記第2の境界面の前記光伝搬方向 に対してなす角度 82 (度)が、それぞれ、以下の式を 満たすようにしたことを特徴とする請求項29記載の光 送受信装置の製造方法。

 $\theta 1 < 90 - \sin^{-1}(1/n)$

【請求項31】 前配光導波路の少なくとも一終端が、

前記光伝搬方向とほぼ直交すると共に、外部から入射した送信光をほぼそのままの方向に通過させることが可能な端面をなすようにしたことを特徴とする請求項29記載の光送受信装置の製造方法。

【請求項32】 前記光導波路の少なくとも一終端が、

前記光伝搬方向に対してこれと交差するような所定の角度をなすと共に、光導波路の上面または側面から入射し 10 た送信光を内面で反射させることが可能な端面をなすようにしたことを特徴とする請求項29記載の光送受信装置の製造方法。

【請求項33】 光導波路の要部を構成する材料の屈折 率がnである場合において、

前記端面の前記光伝搬方向に対してなす角度 θ 3 (度) が、以下の式を満たすようにしたことを特徴とする請求 項32記載の光送受信装置の製造方法。

 $\theta \, 3 < \sin^{-1} (1/n)$

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光を伝搬可能な光 導波路を含んで構成される光導波装置および光送受信装 置、ならびにそれらの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路(IC)や大規模集積回路(LSI)等の分野においては、その技術進歩により、動作速度や集積規模が向上し、マイクロプロセッサの高性能化やメモリチップの大容量化が急速に進んでいる。しかしながら、これらの電子デバイスにおいては、性能向上30を図る上で、電気信号の伝送速度の高速化や信号配線の高密度化がネックとなり、また電気配線における遅延の問題も生じる。さらに、電気信号の伝送速度の高速化や信号配線の高密度化を達成するためには、EMI/EMC(Electro-Magnetic Interface / Electro-Magnetic Compatibility)の対策が不可欠である。これらの配線のネックを解消するものとして、光インターコネクション(光配線)が注目されている。

【0003】この光インターコネクションは、機器装置間、機器装置内ボード間、あるいはボード内チップ間な 40 ど、様々な状況において適用可能と考えられているが、例えばチップ間などのように比較的短距離の伝送においては、基板上に形成した光導波路を伝送路として利用する光伝送通信システムが適していると考えられる。そして、このような光導波路を使用した光伝送通信システムにおいては、光導波路の製作プロセスの確立が重要な課題である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このような光導波路に ることが可能である。この場合、溝状切欠部は、少なく要求される条件としては、光損失が小さく、かつ、でき 50 ともコア部を横断するように形成されていることが望ま

るだけ製造が容易であることが挙げられる。これらの条件を満たすものとして、例えば石英系の材料を用いた低損失な光導波路がある。光ファイパで実証済みのように、石英は光透過性が極めて良好であるため、これで導波路を製作した場合には O. 1 d B/c m以下の低損失化が可能である。しかし、石英を用いた場合には、光導波路製作に長時間を要することや、製作時に高温(800℃以上)となること、大面積化が困難であること、および、コストが高い等の問題点がある。これらの諸問題を解決し、低温プロセスにより光導波路製作を可能にする材料として、ポリメチルメタクリレート(PMMA)やポリイミドなどの高分子材料を用いることが考えられる。

【0005】ここで、光導波路を使用した光伝送の高密度化を考えた場合、光信号が光導波路内を双方向に伝搬するように構成することが望ましい。しかしながら、双方向に光信号を伝搬させようとするシステムにおいては、発光素子から光導波路への入射および光導波路から受光素子への出射の形態や、発光素子および受光素子の光導波路に対する配置の問題、あるいは双方向に伝搬させる信号間のクロストークの問題など、解決すべき様々な問題がある。

【0006】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、基板上に形成された光配線としての光導波路を用いて光信号を双方向に伝搬させることにより双方向通信を可能にした光導波装置および光送受信装置、ならびにそれらの製造方法を提供することにある。 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明の光導波装置は、基板上に形成されると共に光を双方向に伝搬可能な光導波路と、光導波路の少なくとも一終端の近傍における光導波路内に光伝搬方向と交差するように設けられ、光導波路内を伝搬する光を転轍することが可能な薄状切欠部とを備えている。ここで、光導波路は、高分子材料を用いて構成可能であり、また、基板は、シリコン、石英、ガラスおよびセラミックスの少なくとも1つを含む無機材料、または有機材料を用いて構成可能である。

【0008】本発明の光送受信装置は、基板上に形成されると共に、光を双方向に伝搬可能な光導波路と、光導波路の少なくとも一終端の近傍における光導波路内に光伝搬方向と交差するように設けられ、光導波路内を伝搬する光を転轍することが可能な溝状切欠部と、溝状切欠部により転轍された受信光を受光する受光索子と、溝状切欠部に向けて送信光を発する発光索子とを備えている。

【0009】本発明の光導波装置または光送受信装置では、光導波路が、光が伝搬するコア部と、このコア部を囲むように形成されたクラッド部とを含むように構成することが可能である。この場合、溝状切欠部は、少なくともコアのを機断するように形成されていることが望ま

しい。

【0010】また、本発明の光導波装置または光送受信装置では、溝状切欠部が、光導波路内を伝搬してきた受信光を内面で反射させて光導波路内から外部に導くことが可能な第1の境界面と、受信光の伝搬方向と相反する方向に向かう送信光を通過させて光導波路内に導くことが可能な第2の境界面とを有するように構成することが可能である。ここで、光導波路の要部を構成する材料の屈折率をnとすると、第1の境界面の光伝搬方向に対してなす角度 θ 1(度)が、 θ 1 < 90 - s i n - 1(1 / n)を満たし、第2の境界面の光伝搬方向に対してなす角度 θ 2(度)が、 θ 2 > 90 - s i n - 1(1 / n)を満たし、第2の境界面の光伝搬方向に対してなす角度 θ 3 (度)が、 θ 4 > 90 - s i θ 5 θ 6 θ 7 (1 θ 7)を満たすようにすることが好適である。

【〇〇11】また、本発明の光導波装置または光送受信 装置では、光導波路の少なくとも一終端が、光伝搬方向 とほぼ直交すると共に外部から入射した送信光をほぼそ のままの方向に通過させることが可能な端面をなすよう にすると共に、端面を通過して入射してきた送信光が、 第2の境界面、溝状切欠部および第1の境界面を順に通 過して、光導波路内に導かれるように構成可能である。 【0012】また、本発明の光導波装置または光送受信 装置では、光導波路の少なくとも一終端が、光伝搬方向 に対してこれと交差するような所定の角度をなすと共に 光導波路の上面または側面から入射した送信光を内面で 反射させることが可能な端面をなすようにすると共に、 端面で反射した送信光が、第2の境界面、薄状切欠部の 内部および第1の境界面を順に通過して、光導波路内に 導かれるようにしてもよい。この場合には、光導波路の 要部を構成する材料の屈折率をnすると、端面の光伝搬 方向に対してなす角度 θ 3(度)が、 θ 3<sin ¬1 (1/n)を満たすようにすることが好適である。

【0013】本発明に係る光導波装置の製造方法は、基板上に、光を双方向に伝搬可能な光導波路を形成する工程と、光導波路の少なくとも一終端の近傍における光導波路内に、この光導波路内を伝搬してきた受信光を内面で反射させて光導波路の側面から外部に出射させることが可能な第1の境界面および受信光の伝搬方向と相反する方向に向かう送信光を通過させて第1の境界面を介して光導波路内に導くことが可能な第2の境界面を有する溝状切欠部を、光伝搬方向と交差するように形成する工40程とを含んでいる。

【0014】本発明に係る光送受信装置の製造方法は、基板上に、光を双方向に伝搬可能な光導波路を形成する工程と、光導波路の少なくとも一終端の近傍における光導波路内に、この光導波路内を伝搬してきた受信光を内面で反射させて光導波路の側面から外部に導くことが可能な第1の境界面および受信光の伝搬方向と相反する方向に向かう送信光を通過させて第1の境界面を介して光導波路に導くことが可能な第2の境界面を有する滞状切欠部を、光伝搬方向と交差するように形成する工程と、

第1の境界面の近傍における光導波路の側面に、第1の 境界面で反射された受信光を受光するための受光素子を 形成する工程と、端面の近傍に、この端面に向けて送信 光を発するための発光素子を形成する工程とを含んでい る。

【 O O 1 5 】本発明の光導波装置では、基板上に形成された光導波路の少なくとも一終端の近傍における光導波路内に光伝搬方向と交差するように設けられた薄状切欠部によって、光導波路内を伝搬する光が転轍される。ここで、「光が転轍される」とは、光導波路内を伝搬する光が、その伝搬方向に応じて異なる経路へと導かれることを意味する。

【0016】本発明の光送受信装置では、基板上に形成された光導波路の少なくとも一終端の近傍における光導波路内に光伝搬方向と交差するように設けられた溝状切欠部によって、光導波路内を伝搬する光が転轍される。そして、溝状切欠部により転轍された受信光は受光素子により受光される一方、発光素子からは送信光が溝状切欠部に向けて発せられる。

[0017]

30

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

【0018】 [第1の実施の形態] 図1~図3は、本発 明の一実施の形態に係る光送受信装置を双方向光伝送シ ステムに適用した場合の構成の要部を表すものである。 ここで、図3は、光送受信装置の要部の外観構成を表す 斜視図であり、図1は図3における1-1矢視断面を表 し、図2は図3におけるローロ矢視断面を表す。なお、 本発明の実施の形態に係る光導波装置およびその製造方 法は、本実施の形態に係る光送受信装置およびその製造 方法によって具現化されるので、以下併せて説明する。 【〇〇19】これらの図に示したように、本実施の形態 の光送受信装置は、基板11と、基板11上に形成され た光導波路15と、この光導波路15の両終端面18 a、18bにそれぞれ対向して基板11上に配置された 発光素子23a,23bと、光導波路15の両端部の各 近傍における光導波路15の上面(側面)にそれぞれ配 置された受光素子25a,25bとを備えている。基板 11としては、通常、シリコンや石英あるいはガラス等 の無機材料で構成されると共に、髙精度に平坦化された 光回路専用の基板が使用されるが、このほか、電気配線 が施されていて比較的大きな凹凸を有する電気配線基板 であってもよい。さらに、このような電気配線基板は、 例えばセラミックス等の無機材料からなる基板であって も、あるいはガラス・エポキシ系の有機材料からなる基 板であってもよい。ここで、光導波路15が本発明にお ける「光導波路」に対応し、終端面18a, 18bが本 発明における「端面」に対応する。

【0020】光導波路15は、コア部13と、このコア 50 部13の上下左右を囲むように形成されると共に、コア

13よりも小さな屈折率を有するクラッド部12,14 とを有している。コア部13は、後述するような高分子 材料で形成され、クラッド部12、14は、同様の高分 子材料で形成されている。ここで、クラッド部12,1 4が本発明における「クラッド部」に対応し、コア部1 3が本発明における「コア部」に対応する。

【0021】光導波路15の両終端面18a,18bが 基板11の表面となす角度83は、本実施の形態では、 それぞれほぼ90度である。光導波路15の一方の送受 信端部側(以下、A側という。)には、終端面18aと 10 対向するようにして、基板11上に発光索子23aが配 置され、他方の送受信端部側(以下、B側という。)に は、端面18bと対向するようにして、基板11上に発 光素子23bが配置されている。なお、図3ではA側の みを図示している。発光素子23 aは、基板11上に形 成された基体層21aと、この基体層21aの上に形成 された発光層22aとを有している。同様に、発光索子 23bは、基体層21bと発光層22bとを有してい る。これらの発光素子23a,23bとしては、例えば 端面発光型半導体レーザ等の端面発光型発光索子が使用 20 可能である。この場合、発光素子23aの発光層22a の端面から出射した光は、終端面18aに対してほぼ垂 直に入射し、発光素子23bの発光層22bの端面から 出射した光は、終端面186に対してほぼ垂直に入射す るようになっている。

【0022】光導波路15には、そのA側およびB側 に、それぞれ、光導波路15における光伝搬方向(光導 波路15の長手方向)と交差するように設けられた溝状 切欠部31aおよび31bが形成されている。より具体 的には、溝状切欠部31aは、図1および図3に示した 30 ように、コア部13の上側のクラッド部14、コア部1 3、およびコア部13の下側のクラッド部12の3つの 部分を、その順に斜めに横断するように形成されてい る。このように、溝状切欠部31aは、少なくともコア 部13を横断していれば足り、クラッド部12,14を も横断している必要はない。但し、溝状切欠部31aの 長さ方向(図1において、紙面と直交する方向)のサイ ズを拡大して、溝状切欠部31aが、コア部13の上側 のクラッド部14、コア部13およびコア部13の下側 のクラッド部12の3つの部分のみならず、コア部13 40 の両側のクラッド部12, 14をも横断するようにな し、光導波路15が溝状切欠部31aによって完全に分 断される形にしてもよい。なお、本実施の形態では、溝 状切欠部31aが、光導波路15の外部媒質 (例えば空 気)で満たされているものとする。

【0023】 溝状切欠部31aは、主として境界面16 aと境界面17aとにより画成されている。境界面16 aは基板11の表面と角度 θ 1をなし、境界面17aは 基板11の表面と角度 θ 2をなしている。ここで、 θ 2 > heta1である。角度heta1は、図1の左手の方向(B側方 50 く、この境界面17aでスネルの法則に基づく屈折を受

向)から光伝搬方向に沿って光導波路15中を伝搬して くる受信光をすべて第1の境界面16aで内面反射させ て光導波路15の上面から外部に出射することができる ような角度に設定されている。また、角度 θ 2 は、終端 面18aから入射して受信光の伝搬方向(図1の左手か ら右手に向かう方向)と相反する方向(図1の右手から 左手に向かう方向)へ伝搬する送信光が第2の境界面1 7 a を通過して第1の境界面16aへと入射することが 可能な角度に設定されている。なお、これらの角度 θ 1, θ2についてはさらに後述する。 薄状切欠部31b の構造・形状は、溝状切欠部31aと同様であるので、 説明を省略する。ここで、溝状切欠部31a, または3 1 b が本発明における「溝状切欠部」に対応する。ま た、境界面16aが本発明における「第1の境界面」に 対応し、境界面17aが本発明における「第2の境界 面」に対応する。

【OO24】光導波路15のA側およびB側の光導波路 15上には、それぞれ、受光素子25aおよび25bが 配置されている。受光素子25a,25bとしては、例 えばPin型フォトディテクタやMSM(Metal-Shotkey-Metal)型フォトディテクタ等の 面受光型受光素子が使用可能である。

【0025】次に、図1を参照して、以上のような構成 の光送受信装置の作用を説明する。ここでは、送受信端 部の一方であるA側において送受信を行う場合の光学的 原理を説明する。他方の送受信端部(B側)における送 受信の原理は、これと同様であるので、その説明は省略

【0026】まず、送信の原理について説明する。発光 素子23aの発光層22aの端面から基板11とほぼ平 行に出射される送信光は、図1に示したように、光導波 路15の終端面である終端面18aに入射する。ここ で、終端面18aは、上記したように、光伝搬方向(光 導波路15の長手方向)に対してほぼ垂直をなしてい る。このため、終端面18aに入射した送信光は、その まま直進し、溝状切欠部31aにおける発光索子23a 側の境界面17aに到達する。ここで、境界面17a は、光伝搬方向(基板11の表面方向に等しい)に対 し、入射する送信光を全反射させることのない角度 θ 2 をなすように形成されている。すなわち、角度 θ 2 は、 境界面17a面に入射する送信光の入射角が臨界角を超 えないような角度である。より具体的には、角度 82 (単位:度)は、光導波路15のコア部13を構成する 材料の屈折率nに依存し、スネルの法則により、次の (1) 式を満たすように設定される。

[0027]

 $\theta 2 > 90 - s i n^{-1} (1/n) \cdots (1)$

【0028】この(1)式を満たす限り、発光索子23 aからの送信光は、境界面17aで全反射することな

20

けて、これを透過する。例えば、コア部13の屈折率 n が1.5であるとすると、(1)式より、 θ 2>48. 2°となる。すなわち、この場合には、角度θ2が例え ば50°以上であれば、送信光は境界面17aを十分透 過することができ、送信時における光転轍動作が確実に 担保される。

【OO29】境界面17aを通過した送信光は、溝状切 欠部31aの内部を進んで、溝状切欠部31aの境界面 16 aに到達する。送信光は、この境界面16 aにおい てスネルの法則による屈折を受けて光導波路15のコア 10 部13内へと進入し、さらに、コア部13内をB側へと 向かう。なお、送信光が境界面16aからコア部13の 内部に進む際の進入方向は、光伝搬方向に対して若干の 角度をなしているが、光導波路15が、この送信光に対 して伝搬可能で許容できるような開口度(NA)を有し ていれば、送信光は十分なパワーで光導波路15内を伝 搬することができる。ここで、光導波路15の開口度 は、コア部13の屈折率nとクラッド部12,14の屈 折率との差が大きいほど、大きくなり、送信光の伝搬効 率が髙まる。

【0030】次に、受信の原理について説明する。上記 したように、溝状切欠部31aの受光素子25aに近い 側の境界面 16aが光伝搬方向に対してなす角度 θ 1は、B側から光導波路を伝搬してきた光が境界面16a で全反射することとなるような角度になっている。すな わち、角度 θ 1は、第2の境界面に入射する受信光の入 射角が臨界角以上になるような角度である。より具体的 には、角度 81 (単位;度)は、光導波路15のコア部 13を構成する材料の屈折率 n に依存し、スネルの法則 により、次の(2)式を満たすように設定される。

$\theta 1 < 90 - \sin^{-1}(1/n) \cdots (2)$

【OO32】この(2)式を満たす限り、B側から光導 波路15のコア部13の内部を伝搬してきた受信光は、 境界面16aを透過することなく、この境界面16aで 全反射し、光導波路15の上面に配置された受光素子2 5aによって受信される。例えば、光導波路15のコア 部13の屈折率nが1.5であるとすると、 θ 1<4 8. 2度となる。すなわち、この場合には、角度 θ 1が 例えば45°以下であれば、B側からの光は境界面16 40 aで全反射して、受光素子25aに入射することとな り、受信時における光転轍動作が担保されると共に、そ の受光効率が最大となる。

【0033】例えば、コア部13の材料の屈折率nが 1. 5、 θ 1が45°、 θ 2が50°であるとすれば、 発光素子23aからの送信光が境界面17a, 16aを 通過して再び光導波路15の内部に入射する角度は、光 伝搬方向に対して約4度の角度をなすことになり、通常 のNA(例えば、NA=0.2~0.3程度)を有する 光導波路であれば、十分に光結合が可能である。なお、

溝状切欠部31aの幅、すなわち、境界面16aと境界 面17aとの間隔は、これらの2つの境界面のそれぞれ が互いに光学的に影響を受けない程度であれば、できる だけ狭くしてよい。ここで、互いに光学的に影響を受け ない幅とは、具体的には、光の波長オーダー(例えば、 数µm) 以上の幅である。この場合には、コア径が例え ば数十~数百µmのマルチモード光導波路において十分 な光結合が可能となる。一方、B側からの受信光は、境 界面16aで全反射して、受光素子25aにより受信さ れる。

【0034】以上のように、本実施の形態に係る光送受 信装置によれば、光導波路15の一終端側の近傍におけ る光導波路中に、光伝搬方向と交差するようにして、境 界面16a、17aを有する溝状切欠部31aを設け、 B側から光導波路15中を伝搬してきた受信光を境界面 16aで内面反射させて光導波路15の上面から外部に 出射させるようにすると共に、光導波路15のA側の終 端面18aから入射した送信光が境界面17aを透過し て境界面16aに入射するようになしたので、基板上に 形成された単一の光導波路において、比較的単純な構成 により双方向の光信号の転轍を行うことができる。した がって、双方向光送受信システムにおいて、低密度の光 配線によって髙密度の光伝達を達成できる。

【0035】次に、図4ないし図9を参照して、本実施 の形態に係る光送受信装置の製造方法について説明す

【0036】まず、図4~図6に示したような工程によ り、基板11上に、コア部13およびクラッド部12, 14を含む光導波路15を形成する。なお、図4~図6 30 は、光伝搬方向と直交する方向に沿った断面を表すもの

【0037】具体的には、図4に示したように、シリコ ン基板やガラス基板等の平坦な基板11上に、例えばス ピンコート法によって、有機材料からなる厚さ数十µm 程度の下部クラッド層12′を形成し、さらに、熱処理 または紫外線照射等によりこれを硬化させる。下部クラ ッド層12′としては、例えば、ポリイミド、PMMA (Poly Methyl Meta-Acrillate)等のアクリル系樹脂、ビ スフェノール等を主剤とするエポキシ系樹脂、ポリエチ レンやポリスチレン等のポリオレフィン系樹脂、あるい はこれらの物質に弗累を添加したものを用いることがで きる。

【0038】次に、下部クラッド層12′の上に、下部 クラッド層12′よりも屈折率の高い厚さ数十μ m程度 のコア層13′をスピンコート工程および熱処理工程等 によって形成する。コア層13′としては、例えば、上 に列挙した材料(ポリイミド、PMMA等のアクリル系 樹脂、ピスフェノール等を主剤とするエポキシ系樹脂、 ポリエチレンやポリスチレン等のポリオレフィン系樹 50 脂、あるいはこれらの物質に弗累を添加したもの)の中

40

から、下部クラッド層12′として選択した材料の屈折 率よりも十分高い屈折率を有する材料を選択する。

【0039】次に、図5に示したように、フォトリソグ ラフィエ程および反応性イオンエッチング(RIE)エ 程等によってコア層13′をパターニングし、矩形状断 面を有するコア部13を形成する。この場合のコア部1 3の幅は、例えば30μm程度とする。

【0040】次に、図6および図7に示したように、ス ピンコート工程および熱処理工程等により、下部クラッ に厚さ数μm程度に形成したのち、この上部クラッド層 および下部クラッド層12~を選択的にエッチングし て、各光導波路の間を相互に分離する。これにより、基 板11上に、クラッド部12,14によって囲まれたコ ア部13を有する分離型の光導波路15が複数形成され る。なお、図7は、図6の状態における光導波路15の VII-VII矢視図を表す。

【0041】次に、図8に示したように、溝状切欠部3 1a, 31bおよび終端面18a, 18bを形成し、さ らに、図9に示したように、発光索子23aおよび受光 20 素子25aを形成する。ここで、図8および図9は、図 7と同じ方向の断面、すなわち光導波路15の光伝搬方 向に沿った断面を表す。

【0042】 溝状切欠部31a, 31bの形成は、例え ばエキシマレーザ等の髙出力の光ビームを利用したレー ザ加工、イオンビームエッチング、あるいはパウダービ ームエッチング等の各種エッチング加工工程により行 う。ここで、パウダービームエッチングは、微粒粉体か らなるビームによってエッチングを行うものである。こ れらの加工は、例えば、光導波路15の上方から、必要 30 に応じてマスクを使用して行う。このとき、溝状切欠部 31aの境界面16a, 17aの、光伝搬方向に対する 角度 θ 1および θ 2が、上記の(1), (2)式を満た すこととなるように、ビームの径、方向、強度および拡 散度等を制御する。溝状切欠部31bの境界面16b, 17bの角度 θ 1, θ 2についても同様に制御する。

【0043】終端面18aおよび18bもまた、上記と 同様に、レーザ加工、イオンビームエッチング、あるい はパウダービームエッチング等の各種エッチング加工工 程により形成可能である。この場合、溝状切欠部31 a、31bの加工と終端面18a、18bの加工とを同 時に行ってもよいし、異なる工程で形成するようにして もよい。

【0044】次に、図9に示したように、予め製作され た端面発光型の発光素子23a,23bを、光導波路1 5の終端面18a, 18bの各近傍の基板11上に、各 光出射面を終端面18a,18bとそれぞれ対向させる ようにして配置し、これらを接着剤等によって基板11 に固定する。さらに、光導波路15の上面における、境 界面16a,16bの形成位置に対応した位置に、それ 50 も面発光型素子を使用して、双方向の光送受信が可能と

ぞれ、予め製作された面受光型の受光素子25a,25 bを受光面を下に向けて配置し、これらを接着剤等によ って光導波路15上に固定する。

【0045】その後、発光素子23a, 23bおよび受 光素子25a, 25bを、例えばワイヤボンディング等 によって、図示しない電子回路に接続する。これによ り、本実施の形態に係る光送受信装置の主要部の製造が 完了する。

【0046】以上のように、本実施の形態に係る光送受 ド部層12′と同じ材料からなる上部クラッド層を全体 10 信装置の製造方法によれば、光導波路15を形成したの ちに、その上方からレーザ加工等の指向性をもったエッ チング工程により溝状切欠部31aを形成して、送受信 光を転轍(てんてつ)するための境界面16a,17a を形成するようにしたので、多数の工程を要せず、比較 的少ない簡単な工程によって、双方向の光伝送が可能な 光送受信装置を形成することができる。

> 【0047】[第2の実施の形態]次に本発明の第2の 実施の形態について説明する。

【0048】図10は、本発明の第2の実施の形態に係 る光送受信装置の断面構造を表すもので、上記第1の実 施の形態における図1に対応するものである。なお、こ の図で、上記の図1で示した構成要素と同一の構成要素 には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。

【〇〇49】本実施の形態では、発光索子として、端面 発光型に代えて面発光型の発光素子122a, 122b を用いるようにしたものである。発光素子122a, 1 22bとしては、例えばVCSEL (Vertical Cavity Surface Emission Laser) 等の発光素子が使用可能であ

【0050】本実施の形態では、発光素子122a,1 22 bは、上記第1の実施の形態の場合のように基板1 1上に配置するのではなく、光導波路115の両端部近 傍における光導波路115上に、光出射面を下向きにし て配置する。また、光導波路115の終端面118aが 光伝搬方向に対してなす角度 8 3 は、上記第1の実施の 形態の場合とは異なり、発光素子122aから下向きに 出射されて入射してきた送信光が終端面118aで全反 射することとなるような角度とする。具体的には、スネ ルの法則により、次の(3)式を満たす角度とする。

 $[0051] \theta 3 > \sin^{-1} (1/n) \cdots (3)$

【0052】本実施の形態では、発光素子122aから 下向きに出射されて光導波路115内に入射してきた送 信光は、終端面118aで全反射して光導波路115内 をその長手方向に進み、境界面17aを通過して溝状切 欠部31a内部に進む。その後の送信光の伝搬過程、お よびB側からの受信光の受信過程は、上記第1の実施の 形態の場合と同様であり、説明を省略する。

【0053】以上のように、本実施の形態に係る光送受 信装置によれば、受光索子のみならず発光索子について

なる。

【0054】以上、いくつかの実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれらの実施の形態に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、上記の各実施の形態では、光導波路15,115は、互いが分離された形態のものであるとして説明したが、例えば図11に示したように、光導波路の相互間が分離されていない形態のものであってもよい。なお、図11は、光導波路における光伝搬方向と直交する方向に沿った断面を表すもので、上記実施の形態における図6に対応する。この図に示した変形例では、コア部13は、クラッド層12および34からなるクラッド部の中に完全に埋め込まれた形となっている。光導波路の端部近傍に、上方の日にでは、コア部13およびクラッド層12を付よがある。光導波路の端部近傍に、上方の日にでは、コア部13およびクラッド層12を向場である。

【0055】また、上記各実施の形態では、光導波路の送受信端部A側およびB側にそれぞれ溝状切欠部31 a,31bが形成されているものとして説明したが、いずれか一方にのみ本発明の実施の形態に係る溝状切欠部2031aを形成し、他方側には、他の構成の送受信機構を形成するようにしてもよい。

【0056】また、上記各本実施の形態では、溝状切欠部31aの内部は外部雰囲気媒質(空気等)によって満たされているものとして説明したが、本発明はこれに限定されず、コア部13の屈折率よりも小さい屈折率をもつものであれば、他の媒質で溝状切欠部31aが満たされているようにしてもよい。この場合、他の媒質として、例えば不活性な媒質を用いるようにすれば、境界面16a,17aおよび境界面16b,17bにおける反30射性能や透過性能の経時変化を防止することも可能である。

[0057]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1ないし請求項10のいずれかに記載の光導波装置、請求項11ないし請求項23のいずれかに記載の光送受信装置、請求項24ないし請求項28のいずれかに記載の光導波装置の製造方法、または請求項29ないし請求項33のいずれかに記載の光送受信装置の製造方法によれば、基板上に形成されると共に光を双方向に伝搬可能な光導波路の40少なくとも一終端の近傍における光導波路内に、この光導波路内を伝搬する光を転轍することが可能な溝状切欠部を、光伝搬方向と交差させて設けるようにしたので、光導波路内を伝搬する光を、その伝搬方向に応じて異なる経路へと導くことができる。したがって、単一の光導波路を用いて双方向の光信号送受信が可能となり、光導波路を使用した光伝送の高密度化を容易に達成できるという効果を奏する。

【0058】特に、請求項4ないし8のいずれかに記載 の光導波装置、請求項14ないし23のいずれかに記載 50 の光送受信装置、請求項24ないし28のいずれかに記 載の光導波装置の製造方法、または請求項29ないし3 3のいずれかに記載の光送受信装置の製造方法によれ ば、溝状切欠部が所定の機能を有する第1の境界面と第 2の境界面とを有するようにしたので、比較的簡単な構 造で、光導波路内を伝搬してきた受信光を光導波路外に 導くと同時に、受信光と逆方向に向かう送信光を光導波 路内に導くことができるという効果を奏する。

【0059】さらに、請求項5記載の光導波装置、請求項15記載の光送受信装置、請求項25記載の光導波装置の製造方法、または請求項30記載の光送受信装置の製造方法によれば、第1の境界面が光伝搬方向に対してなす角度 01を、その面に入射する受信光の入射角が臨界角以上になるようにすると共に、第2の境界面が光伝搬方向に対してなす角度 02を、その面に入射する送信光の入射角が臨界角を超えないようにしたので、光転轍動作が効率よくかつ確実に行われるという効果を奏する。

【0060】また、請求項6記載の光導波装置、請求項17記載の光送受信装置、請求項26記載の光導波装置の製造方法、または請求項31記載の光送受信装置の製造方法によれば、光導波路の少なくとも一終端が、光伝搬方向とほぼ直交すると共に外部から入射した送信光をほぼそのままの方向に通過させることが可能である端面をなすようにしたので、送信光の光源を、光導波路の光伝搬方向(長手方向)に配置することが可能になるという効果を奏する。

【0061】また、請求項7もしくは8記載の光導波装置、請求項20ないし23のいずれかに記載の光送受信装置、請求項27もしくは28記載の光導波装置の製造方法、または請求項32もしくは33記載の光送受信装置の製造方法によれば、光導波路の少なくとも一終端が、光伝搬方向に対してこれと交差するような所定の角度をなすと共に光導波路の上面または側面から入射した送信光を内面で反射させることが可能である端面をなすようにしたので、送信光の光源を、光導波路の上面または側面に配置することが可能になるという効果を奏する

【0062】特に、請求項8記載の光導波装置、請求項23記載の光送受信装置、請求項28記載の光導波装置の製造方法、または請求項33記載の光送受信装置の製造方法によれば、光導波路の上面または側面から端面に入射する送信光の入射角が臨界角以上となるようにしたので、その端面における内面反射は全反射となり、送信効率を高めることができるという効果を奏する。

【0063】また、請求項24ないし28のいずれかに 記載の光導波装置の製造方法、または請求項29ないし 33のいずれかに記載の光送受信装置の製造方法によれ ば、基板上に、光を双方向に伝搬可能な光導波路を形成 し、この光導波路の少なくとも一終端の近傍における光 導波路内に、この光導波路内を伝搬してきた受信光を内 面で反射させて光導波路の側面から外部に出射させるこ とが可能な第1の境界面および前配受信光の伝搬方向と 相反する方向に向かう送信光を通過させて前配第1の境 界面を介して光導波路内に導くことが可能な第2の境界 面を有する溝状切欠部を、光伝搬方向と交差するように 形成するようにしたので、多数の工程を要せず、比較的 少ない簡単な工程によって、双方向の光伝送が可能な光 導波装置または光送受信装置を製造することができると いう効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態に係る光送受信装置にお ける、光伝搬方向に沿った断面構造を表す断面図であ る。

【図2】本発明の一実施の形態に係る光送受信装置にお ける、光伝搬方向と直交する方向に沿った断面構造を表 す断面図である。

【図3】本発明の一実施の形態に係る光送受信装置の外 観構成を表す斜視図である。

造方法における一工程を表す断面図である。

【図5】図4に続く工程を表す断面図である。

【図6】図5に続く工程を表す断面図である。

【図7】図6に示した工程における光導波路の他の断面 構造を表す断面図である。

【図8】図7に続く工程を表す断面図である。

【図9】図8に続く工程を表す断面図である。

【図10】本発明の第2の実施の形態に係る光送受信装 置における、光伝搬方向に沿った断面構造を表す断面図 である。

【図11】本発明の実施の形態の変形例に係る光送受信 10 装置における、光伝搬方向と直交する方向に沿った断面 構造を表す断面図である。

【符号の説明】

10…光送受信装置、11…基板、12, 112…クラ ッド部、12′…下部クラッド層、13,113…コア 部、13'…コア層、14,114…クラッド部、14 …上部クラッド層, 15, 115…光導波路、16a, 16b… (第1の) 境界面、17a, 17b… (第2 の) 境界面、18a, 18b, 118a, 118b…終 端面、23a, 23b, 123a, 123b…発光素 【図4】本発明の一実施の形態に係る光送受信装置の製 20 子、25a,25b…受光素子、31a,31b…溝状 切欠部, 34…クラッド層

【図1】

